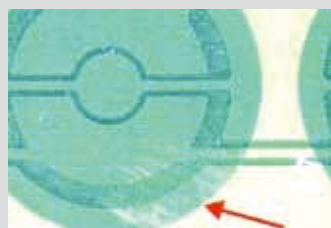


【原因・判断ポイント・発生工程】SR 塗布乾燥後に、何らかの硬い物が強く接触し、擦れたことにより出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】SR 烘干后接触某种坚硬物体、摩擦而引起的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is formed by a strong contact and abrasion on solder-resist surface by something hard after curing. (After solder resist coating and curing process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×

2-1-2-4 SR 打痕／SR 的压痕／Dent on solder resist

【特徴】SR 表面に凹み状の衝突打痕が残されている状態の欠陥

【特征】SR 表面有凹陷的碰撞压痕的缺陷。

【Characteristics】A dent by an impact is left on the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR 塗布乾燥後のハンドリング作業時に、不注意に何かにぶつけて出来たもの（SR 塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】涂布 SR 后的搬运作业时，不小心碰撞某种物体而引起的（SR 烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The solder resist surface is carelessly hit by some object during handling after solder resist coating and curing. (After solder resist coating and curing process)



【コメント】
顕微鏡倍率×
【注釋】
显微镜倍率 ×
【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×8
【注釋】
显微镜倍率 ×8
【Comments】
Magnification: ×8

2-1-2-5 カバーレイ打痕／覆盖层的压痕／Dent on coverlay

【特徴】カバーレイ表面に明確な打痕が認められる欠陥

【特征】在覆盖层表面有明显压痕的缺陷。

【Characteristics】A dent of a definite shape is observed on the surface of coverlay



【コメント】
FPC
顕微鏡倍率×
【注釋】
FPC
显微镜倍率 ×
【Comments】
FPC
Magnification: ×